



## 广东省某公司先进集成电路封装测试扩产项目 可行性研究报告案例

编制单位：北京尚普信息咨询有限公司

联系电话：010-82885739      传真：010-82885785

邮编：100083      邮箱：[hfchen@shangpu-china.com](mailto:hfchen@shangpu-china.com)

北京总公司：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室

网址：<http://plan.cu-market.com.cn/>

<http://www.shangpu-china.com/>

**项目名称：**广东省某公司先进集成电路封装测试扩产项目可行性研究报告

**项目性质：**新建项目

**项目地点：**广东省

**项目背景：**

从整个半导体行业来看，美、日、欧等发达国家和地区仍然占据了绝对的优势地位，上述国家和地区的厂商占据了全球半导体销售市场 80%左右的份额。就集成电路封装产业而言，目前已逐步从欧美发达国家向亚太地区转移，亚洲各国占集成电路封装产业市场的 70%左右。中国是近年来集成电路市场成长最快的地区之一。我国集成电路产业销售规模占全球产业销售收入比重呈逐年上升的态势，2013 年占全球总产业的 13.25%，国内集成电路产业的发展对全球产业的影响越来越突出。

**建设内容：**

项目建设期为 2 年。地块为公司已经购入的土地。



广东省某公司先进集成电路封装测试扩产项目

**项目总投资：**

联系电话：010-82885739      传真：010-82885785  
北京总部：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室

项目预计总投资 36,527.83 万元，其中建设投资 31,888.40 万元。

### 项目结论:

#### 1、经济效益:

本项目的税后内部收益率（IRR）是 18.84%，税前是 24.59%。考虑资金的时间价值后，税后投资净现值是 8,366.44 万元，项目的内部收益率较高，净现值为正，投资价值大。本项目考虑资金的时间价值后，动态税后投资回收期是 8.96 年（含建设期 4 年），项目的投资回收期相对较短，风险较小。。

#### 2、社会效益:

本项目为先进集成电路封装测试扩产项目，项目的实施将优化公司产品结构，改善公司现有产能不足的生产状况，提升公司的市场占有率，增强公司的竞争优势，对公司的长远发展具有重要的意义。

## 尚普咨询各地联系方式

**北京总部：**北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室

联系电话：010-82885739 13671328314

**河北分公司：**河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层

联系电话：0311-86062302 0311-80775186 15130178036

**山东分公司：**山东省济南市历城区二环东路东环国际广场 A 座 20 层

联系电话：0531-61320360 13678812883

**天津分公司：**天津市南开区鞍山西道信诚大厦 3 楼

联系电话：022-87079220 13920548076

**江苏分公司：**江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层

联系电话：025-86870380 18551863396

**上海分公司：**上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 6 楼

联系电话：021-51860656 18818293683

**西安分公司：**西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室

联系电话：029-89574916 15114808752

**广东分公司：**广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层

联系电话：020-84593416 13527831869